

# 2022-2028年中国键合铜丝行业市场全景评估及投资前景规划报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国键合铜丝行业市场全景评估及投资前景规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202107/962977.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2022-2028年中国键合铜丝行业市场全景评估及投资前景规划报告》共七章。首先介绍了键合铜丝行业市场发展环境、键合铜丝整体运行态势等，接着分析了键合铜丝行业市场运行的现状，然后介绍了键合铜丝市场竞争格局。随后，报告对键合铜丝做了重点企业经营状况分析，最后分析了键合铜丝行业发展趋势与投资预测。您若想对键合铜丝产业有个系统的了解或者想投资键合铜丝行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 概述

#### 第一节 键合内引线材料

一、半导体的引线键合技术发展

二、引线键合技术（WB）

三、载带自动键合技术（TAB）

四、倒装焊技术（FC）

#### 第二节 键合丝及作用

一、键合丝定义及作用

二、键合丝在IC封装中的作用

#### 第三节 键合丝的主要品种

#### 第四节 键合金丝的主要品种分类

一、按用途及性能划分

二、按照键合要求的弧度高低划分

三、按照键合不同封装形式划分

四、按照键合丝应用的不同弧长度划分

### 第二章 键合铜丝行业、市场的情况

#### 第一节 国际半导体封装用键合丝行业发展概述

#### 第二节 封装用键合丝行业的发展特点

#### 第三节 国际键合丝的市场情况

一、键合铜丝市场发展历程

二、企业制造技术的发展推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变

三、当前国际及我国键合丝行业面临的问题

四、国际键合铜丝的市场规模

## 五、国际键合铜丝的市场格局

### 第四节 我国键合铜丝的市场情况

#### 一、我国整体键合丝市场需求量情况

#### 二、我国键合铜丝市场需求量情况

## 第三章 键合铜丝的性能与国外技术发展

### 第一节 半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求

#### 一、引线键合在半导体封装制造中的应用

#### 二、对半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求

#### 三、对键合铜丝的主要特性要求

##### （一）对键合铜丝的物性要求

##### （二）对键合铜丝的表面性能要求

##### （三）对键合铜丝的线径要求

### 第二节 键合丝的主要采用的标准情况

#### 一、国内外半导体键合用键合丝的主要标准

#### 二、我国半导体键合用铜丝标准的编制情况

### 第三节 键合铜丝的特性

#### 一、键合铜丝与其它键合丝主要性能对比

#### 二、键合铜丝的成本优势

#### 三、键合铜丝的性能优势

### 第四节 国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能

#### 一、国外键合铜丝产品发展概述

#### 二、田中贵金属公司的四种产品

#### 三、新日铁公司的覆PD键合铜丝

#### 四、贺利氏公司的三种键合铜丝产品

#### 五、MEK电子公司的三种键合铜丝产品

## 第四章 键合铜丝的制造工艺过程及产品知识产权情况

### 第一节 键合铜丝的制造工艺技术

#### 一、键合铜丝的制造工艺流程简述

#### 二、具体工艺的环节

##### （一）坯料铸造

##### （二）成丝加工

##### （三）热处理

##### （四）复绕（卷线）

### 第二节 键合铜丝制备过程及影响因素

### 第三节 键合铜丝的组织与微结构

#### 第四节 键合铜丝知识产权情况

- 一、国际及我国键合铜丝专利情况
- 二、新日铁公司实施专利战略的情况

#### 第五章 国际键合铜丝的主要生产企业现况

##### 第一节 国际键合金丝的主要生产厂家概述

##### 第二节 国际键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

- 一、田中贵金属株式会社
- 二、贺利氏集团

#### 第六章 我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况

##### 第一节 概述

- 一、中国键合丝行业总况
- 二、中国键合丝生产及其企业分布情况
- 三、中国键合铜丝行业的生产情况

##### 第二节 中国键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

- 一、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司
- 二、烟台招金励福贵金属股份有限公司
- 三、河南优克电子材料有限公司
- 四、广州佳博金丝科技有限公司
- 五、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

#### 第七章 键合铜丝应用市场的现状与发展

##### 第一节 国际半导体封测产业概况及市场

##### 第二节 我国半导体封测产业发展及现况

- 一、中国IC封装测试业生产现况
- 二、我国国内分立器件生产企业情况（ZY ZS）

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202107/962977.html>